

関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

レンゴーは『東京パック 2021』に出展します

来たる2月24日より、東京ビッグサイトにて2021 東京国際包装展（東京パック 2021）が開催され、当社も出展いたします。

当社ブースでは、『NEXT! 次の世代へ ～段ボールが変わる・生活が変わる～』をテーマとして、プレプリント・デジタル印刷の高精細な再現性と可変印刷で商品の魅力を最大限に発信できる『デジパケ』、小売店での開封・陳列の作業性を飛躍的に改善する『レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング（RSDP）』とさらに次世代を目指した『New Smart Display Packaging（NSD）』のほか、生分解性素材や抗ウイルス製品、通販パッケージシステム等の当社の開発製品、技術を幅広くご覧いただけます。

より少ない資源で大きな価値を生む“Less is more.”をコンセプトに、包装の新たな価値を創造し続ける「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=GPI レンゴーの最先端を是非ともご覧賜りたくご案内申し上げます。

<東京パック 2021 概要>

1. 名 称 2021 東京国際包装展 -東京パック 2021- <https://www.tokyo-pack.jp/>
1966年から開催されるアジア地域最大規模の国際包装展です。
2. 日 程 2021年2月24日(水)～26日(金) 10:00～17:00
3. 場 所 東京ビッグサイト(東京国際展示場)西1～4ホール、南1～2ホール
東京都江東区有明3-11-1
4. 主 催 公益社団法人日本包装技術協会（J P I）
5. レンゴー出展ブース位置 西1ホール22番（W1-22）
6. 入場料 無料 ※入場には、ご登録が必要です。

なお、新型コロナウイルス感染防止対策には鋭意努めてまいりますので、ご来場の皆様にもご協力の程お願い申し上げます。



以上